

Avalon AVTEC 2000

Sistema de Nivelamento por Ar Quente - Brochura Técnica (Tradução)

Documento traduzido: brochura técnica do sistema Avalon AVTEC 2000, referente ao processo Hot Air Leveling (HAL/HASL) utilizado na fabricação de placas de circuito impresso.



1. Descrição do sistema

O sistema AVTEC 2000 da Avalon é uma estação industrial projetada para o processo de nivelamento por ar quente (HAL / HASL) na fabricação de placas de circuito impresso. Sua principal função é imergir mecanicamente a placa de circuito impresso (PCB) em um reservatório de solda eutética fundida e, em seguida, remover o excesso de solda por meio de facas de ar quente de alta pressão, assegurando um revestimento uniforme, plano e de alta soldabilidade nas trilhas e ilhas de cobre expostas.

2. Especificações técnicas (padrão da indústria)

PARÂMETRO OPERACIONAL	FAIXA / VALOR TÍPICO
Capacidade do reservatório de solda	250 kg - 350 kg (aprox.)
Temperatura de operação (com chumbo)	230°C - 260°C
Temperatura de operação (sem chumbo)	260°C - 275°C
Pressão das facas de ar	2,5 - 4,5 bar (ajustável)
Temperatura do ar de nivelamento	210°C - 250°C
Tamanho máximo do painel PCB	24" x 24" (610 mm x 610 mm)
Tamanho mínimo do painel PCB	4" x 4" (100 mm x 100 mm)
Faixa de espessura da PCB	0,4 mm - 3,2 mm
Tempo médio do ciclo de processo	8 a 15 segundos por painel

Observação: os termos técnicos foram mantidos em português com a sigla original em inglês quando aplicável, para preservar a rastreabilidade da descrição técnica do equipamento.